

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

关于在手订单情况的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）从事对集成电路制造与先进晶圆级封装制造行业至关重要的清洗设备、电镀设备、立式炉管系列设备、前道涂胶显影Track设备、等离子体增强化学气相沉积PECVD设备、无应力抛光设备、后道晶圆级先进封装工艺设备、面板级先进封装设备以及硅材料衬底制造工艺设备等的研发、制造和销售。2026年以来，半导体专用设备制造业延续高速增长态势，公司凭借技术优势、产品成熟度和市场认可度，不断深耕现有市场、拓展新市场，收入实现持续增长。为了让投资者更好地了解公司经营情况，现将截至2026年9月29日的在手合同订单情况公告如下：

一、截至2026年9月29日在手订单情况

截至2026年9月29日，公司在手订单总金额为170.73亿元，与上年同期已自愿性披露的在手订单金额相比，在手订单总金额同比增加88.20%。

二、相关说明及风险提示

1、在手订单含已向客户交付但尚未根据中国会计准则获得客户确认收入的设备订单及将于未来交付的设备订单；

2、以上订单受具体执行、实施进度等因素影响，对公司当期和未来年度的业绩影响存在不确定性；在履行过程中如果遇到不可抗力等因素的影响，部分订单可能会存在部分或全部无法履行或终止的风险；

3、以上在手订单数据源自公司内部统计，未经审计，不能以此直接推算公司全年营业收入、净利润等财务数据，仅供投资者及时了解公司日常经营概况。

具体准确的财务数据以公司正式披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026年10月1日